

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Влияние условий нанесения и ионно-плазменной обработки тонких пленок кобальта на их электросопротивление

И. И. Амиров, Р. В. Селюков, В. В. Наумов, Е. С. Горлачев

3

Металлизация переходных отверстий в кремниевых пластинах для создания трехмерных микроструктур

А. И. Воробьева, В. А. Лабунов, Е. А. Уткина, Д. В. Грапов

10

Влияние растекания резиста при его сухом электронно-лучевом травлении на латеральное разрешение

А. Г. Исаев, Ф. А. Сидоров, А. Е. Рогожин

21

Кинетика объемных и гетерогенных процессов в плазме смеси $C_4F_8 + O_2 + Ag$

А. М. Ефремов, Д. Б. Мурин, А. М. Соболев, К.-Н. Kwon

27

Модификация пленок диазохинон-новолачного фоторезиста имплантацией ионов сурьмы

С. Д. Бринкевич, Д. И. Бринкевич, В. С. Просолович

36

Влияние состава смеси на электрофизические параметры и спектры излучения плазмы хлороводорода с хлором и гелием

С. А. Пивоваренок, Д. Б. Мурин, Д. В. Ситанов

43

МАТЕРИАЛЫ

Экспериментальное исследование влияния пористости тонкопленочных анодов на основе кремния на их зарядно-разрядные характеристики

Т. Л. Кулова, Л. А. Мазалецкий, А. А. Мироненко, А. С. Рудый, А. М. Скундин, Ю. С. Торцева, И. С. Федоров

49

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Численное моделирование криогенного травления: модель с отложенной десорбцией

М. К. Руденко, А. В. Мяконьких, В. Ф. Лукичев

58

ПРИБОРЫ

Влияние технологических примесей на электрофизические параметры МОП-транзистора

В. Б. Оджаев, А. Н. Петлицкий, В. С. Просолович, В. А. Филипеня, В. Ю. Явид, Ю. Н. Янковский

68

Прецессия доменной стенки в узком магнитном нанопроводе

О. С. Трушин, Н. И. Барабанова

74

Вниманию авторов

80